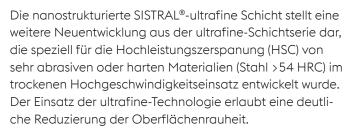


SISTRAL®-ULTRAFINE

Die nanostrukturierte ultrafine-Schicht für die Hochleistungszerspanung



Durch die Verringerung des Makropartikel-Eintrages wird eine glattere Schichtoberfläche und defektarme Schichtstruktur erreicht. Diese weist, insbesondere bei der Hart-, Trocken- und Hochleistungszerspanung einen höheren Verschleißwiderstand und eine verbesserte Standzeit durch Reibungsreduzierung auf.

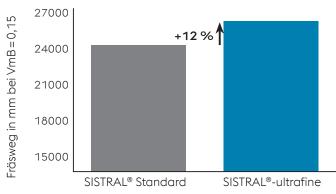
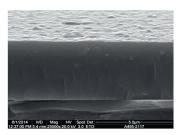


Abb. 1: Maximal erzielter Fräsweg bei einer Verschleißmarkenbreite von 0.15 mm beim Hartfräsen von Vanadis 10 (62 HRC). Zerspanungsparameter: v_c =100 m/min, v_f =1.337 mm/min, a_p=10 mm, a_p=0,02 mm



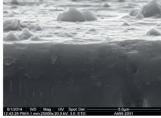


Abb. 2: Rasterelektronenmikroskop-Bruchbild der SISTRAL®-ultrafine (links) und SISTRAL®-Schicht (rechts).

SCHICHTEIGENSCHAFTEN

Härte	2.500 ±300 HV (>3.000 HV auf Anfrage möglich)
Schichtdicke	2-3 µm
Max. Einsatztemperatur	900 °C / 1.650 °F
Farbe	Anthrazitblau
Schichtzusammensetzung	AITiXN-basiert

ANWENDUNGEN

Zerspanung	Hart-, Trocken- und Hochleistungs- zerspanung: Bohren, Drehen, Sägen
Weitere	Weitere Anwendungsgebiete, bei denen extrem hohe Oxidations- und Verschleiß-beständigkeit sowie hohe Warmhärte gefragt sind.

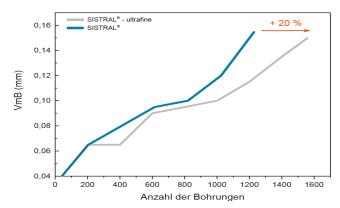


Abb. 3: Verschleißmarkenbreite als Funktion der Anzahl der erreichten Bohrungen

Bohrparameter: vc=80 m/min, vf=0,08 mm/rev, ap=20 mm, Avilub 10 %

